CO₂ レーザを用いた微細三次元形状測定機用 極小径光ファイバスタイラス加工技術の開発

 北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科 准教授 村上 洋
(平成 28 年度 一般研究開発助成 AF-2016208)

キーワード: CO2 レーザ, 微細形状測定, 光ファイバ

1. 研究の目的と背景

近年,微細金型,各種ノズル穴,光通信・医療機器,半 導体・MEMS・マイクロマシン等の分野において, 立体的で 微細な三次元形状部品が増加しており,加工の高精度化・ 製品の高機能化のためこれらを精密に測定するニーズが 増加している. 例えば, TSV (Through-Silicon Via, シリ コン貫通電極)(1)は半導体チップの内部を垂直に貫通する 電極用の微細穴(直径10 µm, 深さ100~500 µm)である が,エッチングによる微細穴加工条件最適化のため,その 側壁粗さの測定が要求されている. 従来技術では測定が不 可能な直径が 10 µm 以下の微小径穴や溝, 側壁粗さの測 定に対応可能な微細三次元形状測定装置実用化のために は、スタイラスの小型化・小径化(直径1 µm 以下)と高 機能化(高分解能,低測定力)が必要である.そこで我々 は、極小径(直径数 µm 以下)の光ファイバスタイラスを 用いた微細三次元形状測定機を開発中である.図1,図2 に、測定装置の概略図およびスライラスレーザ照射部の概 射部断面図を示し、光ファイバプローブの測定原理を示す. 光ファイバの先端を溶融させて製作した接触子が固定さ れたものをスタイラスとして用いる. スタイラスシャフト は姿勢調整用のチューブ型ピエゾ駆動素子に固定されて いる.また、スタイラスに対して約60度傾いた位置に波 長 405 nm の半導体レーザが設置されており、スタイラス シャフトに向かって XY 方向から集束レーザ光を照射する. レーザ光はプリズム内を通り上方へと反射され、スタイラ スシャフトに照射される.スタイラスシャフトを透過した 光は、スタイラスを間にして反対側に 設置された2組の 2分割型フォトダイオードで受光する.図2に示すように 集束レーザ光を斜め上方より照射後, プリズムで反射させ レーザ光をスタイラスの斜め下方向から照射することで, レーザ光および 2 分割型フォトダイオードをスタイラス のレーザ照射部よりも上方に設置することが可能になり, 測定対象物との干渉を回避できる.ここで、スタイラスシ



図1 微細形状測定機概略図

ャフトはロッドレンズとして利用することで,スタイラス の変位を拡大している. ここで, 各フォトダイオードで検 出する光強度値は電圧値に変換され、図3(a)に示すよう にそれぞれ*I_{PX1}, I_{PX2}, I_{PY1}, I_{PY2}(V)とする. 接触子が測定対* 象面に接触していない状態では、*I*_{PX1},*I*_{PX2}および*I*_{PY1},*I*_{PY2} は同一強度に保たれているが,接触子が測定対象面に接触 し,スタイラスシャフトがたわみ,スタイラスシャフトの レーザ照射位置が変位すると*I*_{PX1}, *I*_{PX2}および*I*_{PY1}, *I*_{PY2}の 光強度に差が生じ、接触方向を検出できる. 例えば、図3 (a)の初期状態では、 $I_{PX1} = I_{PX2}$ および $I_{PY1} = I_{PY2}$ であるが、 図3 (b)に示すように X 方向にプローブ用ファイバが変 位すると、光ファイバ内部を透過するレーザの屈折方向が 変わるため $I_{PX1} = I_{PX2}$ および $I_{PY1} > I_{PY2}$ となる.ここで, *I*_{PY1}および*I*_{PY2}を用いた X 方向変位の出力*I*_X(V), *I*_{PX1}およ びIPX2を用いた Y 方向変位の出力Iy(V)を式(1), (2)で定 義する.出力Ix、出力Iyは、半導体レーザを変調するファ ンクションジェネレータの信号を参照信号とし,ロックイ ンアンプを用いて同期検波することで各種ノイズを取り 除いている. 測定対象物表面を XYZ ピエゾステージを用い てスタイラスで順次走査することにより測定する.一般的 にはスタイラス接触子の測定対称面への接触を検知する センサ機構に力を伝えるためにスタイラスシャフトの剛 性を高くする必要があるが,本測定原理ではスタイラスシ ャフトのたわみをレーザを用いて非接触で間接的に検出 する方式であるため、剛性が低く小径で長いスタイラスを 使用可能であり,高アスペクト比の穴や溝などの測定に対 応可能である.

$I_X = I_{PY1} - I_{PY2}$	(1)
$I_Y = I_{PX1} - I_{PX2}$	(2)

ここで, 上記に記載した微細壁面粗さなどの測定要求に 対応するためには, 先端が球形状のスタイラスや極小径で 先端が曲り鋭利なスタイラスが必要である(粗さ測定機な どで一般的に用いられる円錐状のスタイラスでは穴や溝 の測定はできない.) そこで, フッ化水素酸によるウェッ トエッチングと CO₂ レーザを用いることで直径が 1 µm 以 下のスタイラスシャフトの先端部を図 1 に示す形状に短 時間で高精度に製作可能な加工方法の開発を行った.





2.実験方法

2・1 スタイラス小径化・先端先鋭化技術の開発

スタイラスシャフトは各種酸を用いたウェットエッチ ングにより直径 125 µm の光ファイバを小径化し製作して いる.図4に示すように温調器にエッチング液が入って容 器を設置し,光ファイバスタイラスの先端を浸漬してエッ チングを行った.



図4 エッチング装置

図5にエッチング温度とエッチング速度の関係を示す. エッチング液の温度と平均のエッチング速度は図4のように指数関数による近似が可能となる.つまり,温度に対して指数関数的に反応速度が上昇しており,アレニウスの式ともよく一致していることが分かる.





このエッチング温度および時間を制御することにより, 図6に示すように直径が約0.4 µmのスタイラスシャフト を製作することができた.また,先端部をエッチング液に 浸漬し,表面張力により図7に示す先端半径約25 nmの 先鋭化スタイラスを製作可能であることを確認した.



図6 製作したスタイラスシャフト例



図7 製作した先鋭化スタイラスの例

2・2 CO2 レーザを用いたスタイラス先端球成形 および曲げ加工技術の開発

CO₂レーザを用いたスタイラス先端球の製作方法およ び曲げ加工方法について紹介する.図8に CO₂レーザに よる接触子製作装置の概略図を示す.前項記載のエッチン グ方法で製作したスタイラス先端部に対物レンズによっ て集光した CO₂レーザを照射し溶融させ,表面張力によ り接触子を成形する.スタイラスの鉛直下方向から CO₂ レーザを照射して接触子を形成する.図9に製作したスタ イラスの写真を示す.図9(a)はスタイラスシャフト直径 約 0.4 µm, 接触子直径約 1.2 µm, 図 9 (b)はスタイラスシ ャフト直径約 1 µm, 接触子直径約 3 µm, 図 9 (c)はスタ イラスシャフト直径約 2.5 µm, 接触子直径約 5 µm, であ る. 直径約 0.4 µm の極小径のスタイラスシャフトでも CO₂ レーザを用いることで球形状に成形可能であること を確認した.



図8 CO2 レーザによる先端球製作方法





(b)



図9 製作したスタイラス

次に, 微細壁面粗さなどの測定要求に対応するためには, 極小径で先端が曲り鋭利なスタイラスが必要である.2.1 項で先鋭化したスタイラスシャフトの一部を CO₂ レーザ で加熱することにより先端を曲げることが可能である.図 10に先端を曲げたスタイラスの写真を示す.



図10 先鋭化曲げスタイラス

3. 結言

本研究では、ウェットエッチングおよび CO₂ レーザを 用いた微細三次元形状測定機用極小径光ファイバスタイ ラスの製作方法について検討した.その結果、直径約 0.4 µm のスタイラスシャフトや先端球が約 1 µm のスタイラ ス,および粗さ測定用の先鋭化曲げスタイラスが製作可能 であることを確認した.今後は、表面間力によるスタイラ ス先端球の測定対象面への付着を防止するため、スタイラ スへの各種コーティング手法の開発について取り組む予 定である.

謝 辞

本研究の一部は公益財団法人天田財団,戦略的基盤技術 高度化支援事業,および科学研究費補助金を受けて行った ことを記し,謝意を表す.

参考文献

 Victor Vartanian, et al., Metrology needs for through-silicon via fabrication, J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS 13 (1) 011206, (2014) 1-9.